

LDT シリーズエレメント (リード線付き、ラミネート処理)



LDTの「L」は、ラミネート加工された (laminated) センサであることを意味します。通常、 $28\mu\text{m}$ または $52\mu\text{m}$ の piezofilm エlement に 0.005 インチ ($125\mu\text{m}$) のポリエステル層によるラミネート加工が施されています。曲げモードで使用される場合、ラミネート加工されたフィルムエレメントが曲げられると、ラミネート加工されていない DT エlement シリーズよりはるかに高い電圧出力が発生します。中立軸がフィルムではなくラミネート上にあるため、曲げたときにフィルムの歪みがより大きくなります。

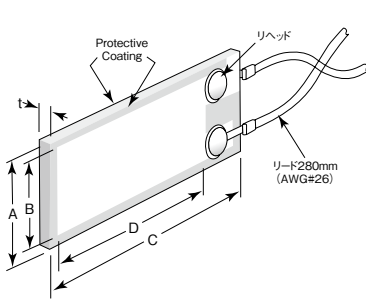
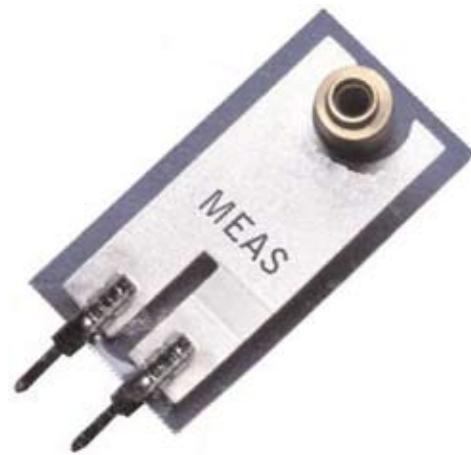
を取り去ります。事前に PCB に錫を盛り、センサを基板にすばやく半田付けします。半田ごてがフィルムに接触しないようにしてください。また、ピンへの滞留時間が 5 秒を超えないようにしてください。低温半田を使用することもできます。

この用途には、車両警報器用のビームタイプの振動センサ、カウンター用のソリッドステートスイッチ、モーメンタリクローズ (瞬時閉鎖) タイプのスイッチなどがあります。

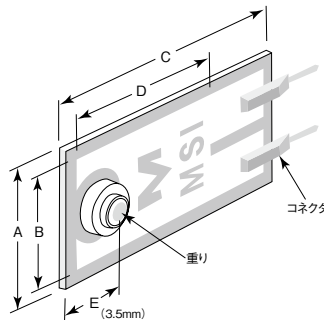
静電容量はエレメントの面積に比例し、厚さに反比例します。

piezofilm センサの LDT エlement には、リード線の取付けに様々なタイプがあります。感度を大幅に向上することを目的とした LDTM-028K (M-Mass) は、LDT0-028K の形状で質量が 0.72g 増加しています。LDT1、2、4 には、12 インチ (300 mm) 長の AWG26 のツイストペア線が取り付けられています。

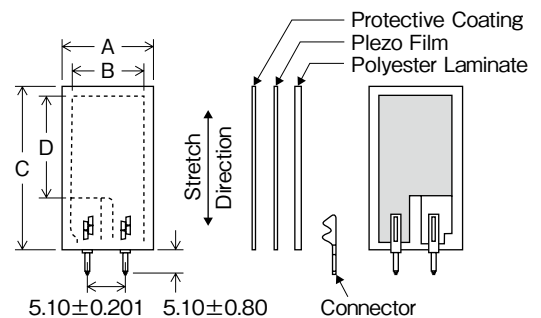
半田用タブ付きの LDT0-028K および LDTM-028K は、十分な注意を払うことによって PCB に直接半田付けできます。piezofilm は高温 (80°C 以上) には耐えられないため、PCB へのピンの半田付けはすばやく行う必要があります。フィルムとクリップの接合部分にクランプされているヒートシンクは、フィルムから熱



(LDT Series with rivets & wire leads)



(LDTM)



(LDT0-028K with crimped on solder tabs)

型番	シート部寸法 (mm)		電極部寸法 (mm)		PVDF 厚 μm	全体厚 μm	静電容量 (nF)	数量 枚	製品番号
	A	C	B	D					
LDT0-028K クリップ付	13	25	10	14.7	28	205	0.5	5	1002794
LDT1-028K/L	16	41	12	30.17	28	205	1.38	5	1-1002910-0
LDT2-028K/L	16	72	12	61.47	28	205	2.78	5	1-1003745-0
LDT4-028K/L	21	170	18	155.7	28	205	11.00	5	1-1002405-0
LDTM-028K	13	25	10	14.7	28	205	0.42	5	1005447-1